

経営方針と対処すべき課題（有価証券報告書より）

① 目指す姿と数値目標

経営課題認識

国内外の半導体メーカー需要を取り込み、結晶技術・微細化技術の開発に対応

② 中長期の経営戦略

1. 技術開発

8インチウェーハの結晶技術確立、12インチハイエンド再生技術高度化、12インチプライム量産安定化、蓄電池海外生産体制確立

3. 製造体制

高集積化対応、最先端設備拡充、高度人材確保、環境配慮した自動化ライン構築

2. 営業施策

米国・欧州・台湾・シンガポール・中国・韓国など海外取引強化。大手メーカー安定取引確保と新規顧客開拓、モニターウェーハ・装置部材販売強化、蓄電池電解液グローバル拡販

4. 海外事業体制

世界顧客需要対応の事業体制強化。艾索精密部件（惠州）有限公司を中心とした新規事業立ち上げ

③ 対処すべき課題

① 半導体需要への対応

- ・AI関連需要拡大に対応した世界的な需要取り込み
- ・半導体メーカーからの需要増加に応える営業強化

② 製造技術の進化対応

- ・世界最先端の12インチハイエンド向け再生技術高度化
- ・年々進む微細化技術への適応が急務

③ 海外展開強化

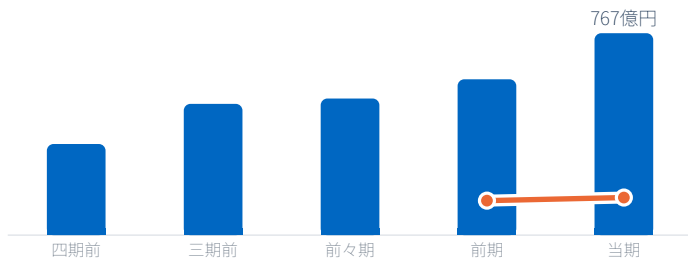
- ・米国・欧州・台湾・シンガポール・中国・韓国との取引拡大
- ・艾索精密部件（惠州）有限公司での新規事業確立

面接で使えるポイント

- ・半導体市場のAI関連需要拡大を背景に、グローバルな顧客開拓と技術開発が経営課題
- ・8インチ・12インチウェーハの結晶技術と微細化技術の両立が競争力の鍵
- ・米国・欧州・台湾など6地域での営業強化と艾索精密部件新規事業が成長戦略

証券コード 3445

業績の推移（売上＝棒 / 営業利益＝線）



※営業利益は直近2期のみ開示（有報の様式変更による）

暗記する数字3つ

連結売上高
767億円

営業利益率
18.6%

財務健康度
64点 / 100点

要するに

電子材料・電子機器部品・通信機器部品材料の製造、加工、再生、販売を行う企業

主力事業・セグメント

- ・半導体機器・素材 39.5%
- ・WaferReclaim 36.0%
- ・PrimeSiliconWafe 24.5%

強み・特徴（公開データから）

- ・営業利益率18.6%と高い収益性
- ・将来性評価は晴れ時々曇り
- ・東証プライム市場上場

※要約はAI生成のため誤りを含む可能性があります

将来性 晴れ時々曇り / 就活偏差値 52.7（当サイト算出の参考指標）

平均年収
640万円

金属製品内 42位/86社

平均年齢
40.6歳

金属製品内 77位/86社

平均勤続
7.1年

金属製品内 82位/86社

女性管理職
10.3%

金属製品内 2位/65社

男性育休
50.0%

金属製品内 42位/60社

※平均年収は提出会社単体・有価証券報告書ベース。順位は同33業種内の掲載企業での比較。

ここから下は自分で書く（面接で話すこと）

志望動機の核

上の数字・事業と接続して書く

自分の経験との接点

逆質問メモ

※1つはデータ起点で（例：勤続年数が長い要因は…）

直近ニュース十一言

参考:(株)RS Technologies【3445】：決算情報

